

Rahmenspezifikation:
Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen
 Deutsche Fassung EN 123400 : 1992

DIN
EN 123400

Der Text dieser Norm umfaßt den Text des Harmonisierungsdokumentes

CECC 123400

Sectional Specification:

Flexible printed boards without through connections;

German version EN 123400 : 1992

Spécification Intermédiaire:

Cartes imprimées souples sans connexions transversales;

Version allemande EN 123400 : 1992

Die Europäische Norm EN 123400 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland das Komitee 661 "Gedruckte Schaltungen" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), von dem die Übersetzung zur Veröffentlichung autorisiert wurde.

Zu den in dieser Norm zitierten IEC-Publikationen bestehen folgende DIN-Normen und andere Veröffentlichungen:

IEC 68	siehe Normen der Reihe DIN IEC 68
IEC 194	siehe DIN IEC 194
IEC 249	siehe Normen der Reihe DIN IEC 249
IEC 326-2	siehe DIN IEC 326 Teil 2
IEC 326-3	siehe DIN IEC 326 Teil 3
IEC 326-7	siehe DIN IEC 326 Teil 7
CECC 23000	siehe DIN EN 123000

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:

Siehe Abschnitt 1.2

— in nationalen Zusätzen:

Normen der Reihe

DIN IEC 68 Elektrotechnik; Grundlegende Umweltprüfverfahren

DIN IEC 194 Gedruckte Schaltungen; Begriffe; Identisch mit IEC 194 : 1988

Normen der Reihe

DIN IEC 249 Basismaterialien für gedruckte Schaltungen; Prüfverfahren

DIN IEC 326 Teil 2 Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 2: Prüfverfahren

DIN IEC 326 Teil 3 Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 3: Gestaltung und Anwendung von Leiterplatten

DIN IEC 326 Teil 7 Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten; Teil 7: Anforderungen an flexible Leiterplatten auf einer oder beiden Seiten ohne Durchverbindungen

DIN EN 123000 Fachgrundspezifikation: Leiterplatten; Deutsche Fassung EN 123000 : 1991

Fortsetzung 1 Seite EN-Norm
 und 26 Seiten CECC-Dokument

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)



Documents

Document Sharing Hub

UDC:

Deskriptoren: Qualität, elektronische Bauelemente, Leiterplatten

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation:

Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen

Sectional Specification:
**Flexible printed boards without
through connections**

Spécification Intermédiaire:
**Cartes imprimées souples sans
connexions transversales**

Diese Europäische Norm wurde vom CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik (CECC) am 12. Dezember 1991 angenommen. Der Text dieser Norm umfaßt den Text der CECC 23 400 Ausg. 1 1985 der zugehörigen CECC Spezifikation. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CECC Generalsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm existiert in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem CECC-Generalsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Mit Ausnahme der nationalen elektrotechnischen Komitees von Griechenland, Island und Luxemburg sind die Mitgliedsländer des CECC mit denen von CENELEC identisch.

CECC

CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

Generalsekretariat: Gartenstr. 179, D- 6000 Frankfurt/Main 70

© 1992 Das Copyright ist den CENELEC Mitgliedern vorbehalten

Système Harmonisé d'Assurance de la Qualité
des Composants Electroniques

SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:

**CARTES IMPRIMEES
SOUPLE SANS CONNEXIONS
TRANSVERSALES**

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

SECTIONAL SPECIFICATION:

**FLEXIBLE PRINTED
BOARDS WITHOUT
THROUGH CONNECTIONS**

Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für
Bauelemente der Elektronik

RAHMENSPEZIFIKATION:

**FLEXIBLE LEITERPLATTEN
OHNE DURCHVERBINDUNGEN**



1 Edition
Issue
Ausgabe

CECC 23400

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
VORBEMERKUNG	2
EINLEITUNG	2
HAUPTABSCHNITT 1 - EINFÜHRUNG	3
Abschnitt	
1.1 Geltungsbereich und Zweck	3
1.2 Bezugsdokumente	3
HAUPTABSCHNITT 2 - ALLGEMEINES	4
HAUPTABSCHNITT 3 - PRÜFLINGE	4
Abschnitt	
3.1 Befähigungsanerkennung	4
3.2 Gütebestätigungskontrollen	5
HAUPTABSCHNITT 4 - EINZELBESTIMMUNG	5
HAUPTABSCHNITT 5 - MERKMALE DER LEITERPLATTEN	5
HAUPTABSCHNITT 6 - BEFÄHIGUNGS-PRÜFPROGRAMM	14
HAUPTABSCHNITT 7 - GÜTEBESTÄTIGUNGSKONTROLLEN	16
HAUPTABSCHNITT 8 - PRÜFBILDER-PRÜFLEITERPLATTEN	19
Abschnitt	
8.1 Anwendung von Prüfbildern und Prüfleiterplatten	19
8.2 Kombiniertes Prüfbild (CTP)	20
8.3 Mehrfachanordnung des kombinierten Prüfbildes	21

VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee für Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mitgliedsländern des Europäischen Komitees für Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisierten Gütebestätigungssystem für elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen und Gütebestätigungsverfahren für elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines international anerkannten Konformitätszeichens oder einer Konformitätsbescheinigung. Die entsprechend den Festlegungen dieses Systems hergestellten Bauelemente werden deshalb in allen Mitgliedsländern ohne weitere Prüfung anerkannt.

Die vorliegende Spezifikation ist vom CECC angenommen worden. Sie wurde für diejenigen Länder erarbeitet, die am System teilnehmen und harmonisierte nationale RAHMENSPEZIFIKATIONEN für FLEXIBLE LEITERPLATTEN OHNE DURCHVERBINDUNGEN herausgeben wollen. Sie ist in Verbindung mit den zur Zeit gültigen Bestimmungen des CECC-Systems zu verstehen.

Zur Zeit der Herausgabe dieser Spezifikation sind folgende Länder Mitglied des CECC: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz und Spanien. Kopien können unter den auf dem blauen Deckblatt befindlichen Anschriften bezogen werden.

EINLEITUNG

Diese Rahmenspezifikation wurde von der WG 23: "Gedruckte Schaltungen" des CECC erstellt.

Sie bezieht sich, wo immer möglich, auf die Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).

Der Text dieser Spezifikation wurde dem CECC mit dem unten aufgeführten Schriftstück zur Abstimmung vorgelegt und vom Präsidenten des CECC zur Herausgabe als CECC-Spezifikation freigegeben.

Schriftstück

Abstimmdatum

Abstimmbericht

CECC(Sekretariat)1626

Januar 1985

CECC(Sekretariat)1728

ANMERKUNG DES SEKRETARIATS:

DA DIESE SPEZIFIKATION VON DER INDUSTRIE DRINGEND BENÖTIGT WIRD, HAT DER PRÄSIDENT DES CECC ENTSCIEDEN, DIESE SPEZIFIKATION ZU VERÖFFENTLICHEN, OHNE DASS SIE DAS VOLLE EDITORIALE VERFAHREN DURCHLAUFEN HAT. BENUTZER DIESER SPEZIFIKATION WERDEN GEBETEN, DARIN ENTDECKTE FEHLER DEM GENERALSEKRETARIAT DES CECC MITZUTEILEN, SO DASS ENTSPRECHENDE ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN KÖNNEN.

1. Einführung

IEC 326-7 ist die IEC-Norm für flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen. Die folgende Spezifikation enthält diese IEC-Norm und in Übereinstimmung mit der Fachgrundspezifikation CECC 23 000 die Angaben, die zusätzlich für Leiterplatten notwendig sind, die unter dem CENELEC System für gütebestätigte Bauelemente der Elektronik behandelt werden sollen.

1.1 Geltungsbereich und Zweck

Dies ist eine Rahmenspezifikation. Sie gilt für flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen unabhängig davon, nach welchen Verfahren sie hergestellt wurden. Sie legt die zu bewertenden Merkmale sowie die für die Befähigungs-Prüfung und die Gütebestätigungskontrolle (losweise und periodische Prüfungen) anzuwendenden Prüfverfahren fest.

1.2 Bezugsdokumente

IEC 68	- Basic environmental testing procedures
IEC 194	- Terms and definitions for printed circuits
IEC 249	- Metal-clad base materials for printed circuits
IEC 321	- Guidance for the design and use of components intended for mounting on printed boards. <i>etc.</i>
IEC 326-2	- Printed boards - Test methods
IEC 326-3	- Design and use of printed boards
IEC 326-7	- Specification for flexible printed boards without through connections
CECC 00 010 (1980)	- Leiterplatten-Prüfverfahren
CECC 23 000	- Fachgrundspezifikation für gütebestätigte Leiterplatten

2. Allgemeines

Diese Rahmenspezifikation (SS) gilt für flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen. Sie ist als Grundlage gedacht für die Erstellung von

- Cap DS, die für bestimmte Materialien, z.B. nach IEC-Publikation 249-2, gelten und die bei Verfahren zur Anerkennung der Befähigung angewendet werden.

Für jedes Material kann eine eigene Cap DS erforderlich sein.

Cap DS können von einer internationalen oder einem nationalen Gremium oder von einem Hersteller erstellt werden (siehe auch CECC 00 111).

- Bauartspezifikationen für die kundenspezifisch hergestellten Leiterplatten; diese werden nach 5 von CECC 23 000 "Kunden-Bauartspezifikation" (CDS) genannt. Die CDS wird üblicherweise vom Kunden erstellt und erhält eine Nummer in dessen eigenem System.

Weitere Einzelheiten sind auch in CECC 23 000 sowie in CECC 00 107 Teil III enthalten.

Tabelle I enthält die grundlegenden Merkmale, die üblicherweise für flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen wichtig sind. Sie verweist außerdem auf die für die Beurteilung dieser Merkmale geeigneten Prüfungen.

Tabelle II enthält zusätzliche Merkmale, die für bestimmte flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen und/oder für bestimmte Anwendungsfälle wichtig sein können. Sie verweist außerdem auf die für die Beurteilung dieser Merkmale geeigneten Prüfungen. Wo nötig, kann die Einzelbestimmung Merkmale und Prüfungen aus dieser Tabelle II anziehen.

Sind in dieser Einzelbestimmung zusätzliche Einzelheiten anzugeben, ist dies mit einem Stern in der entsprechenden Spalte angezeigt. Die Einzelheiten werden dann nach CECC 00 010 (IEC 326-2) festgelegt.

Tabelle III enthält das Befähigungs-Prüfprogramm. Als Bauelement zur Befähigungsanerkennung wird ein festgelegtes kombiniertes Prüfbild (CTP) verwendet.

Tabelle IV enthält Angaben für die Gütebestätigungskontrolle. Die Tabellen legen nicht die Reihenfolge der Prüfungen fest. Falls nicht anders vereinbart, können die Prüfungen in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

3. Prüflinge

3.1 Befähigungsanerkennung

3.1.1 Grundbereich der Befähigungsanerkennung

Die Prüfungen sind an dem in 8 beschriebenen kombinierten Prüfbild durchzuführen.

3.1.2 Erweiterter Bereich der Befähigungsanerkennung

Es gilt 3.5.3 von CECC 23 000. Für Mehrfachanordnungen siehe 8.